(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

® Offenlegungsschrift

① DE 3314637 A1

E 04 D 1/28 F 24 J 3/02

(51) Int. Cl. 3:

H 01 L 31/04



DEUTSCHES PATENTAMT ② Aktenzeichen: P 33 14 637.3 ② Anmeldetag: 22. 4.83 (3) Offenlagungstag: 17, 11, 83

(2) Innere Priorität:

27.04.82 DE 32156219

(7) Anmelder:

BM CHEMIE Kunststoff GmbH, 5678 Wermelskirchen, DE

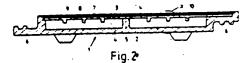
@ Erfinder:

Melchior, Bernd, 5630 Remscheid, DE

2 JAN. 1935 Octrooles:

(S) Dachstein

Die Erfindung betrifft einen Dachstein zum einander überlappenden Bedecken geneigter Dachflächen, bei denen in dem von benachbarten Dachsteinen (1) nicht überdeckten Bereich Halbleiterphotoelemente (7) angeordnet sind. Unterhalb der Halbleiterphotoelemente (7) weist der Dachstein (1) einen Hohlraum (4) auf, der mit den Hohlraumen (4) der darunter und des darüber liegenden Dachsteins verbunden ist. Die Hohlraume (4) der Dachsteine sind von unten nach oben von Luft durchströmt, die der Umgebungs- bzw. Außenluft entnommen wird. Die Halbleiterphotoelemente (7) sind in der den Hohlraum abdeckenden Platte (3) angeordnet oder eingelassen. Die Abdeckplatte (3) ist im wesentlichen lichtundurchlässig, und ihre Unterseite wird von der vorbeiströmen-(3314637)den Luft gekuhlt.



BUNDESDRUCKEREI 09.83 308 046/563

COHAUSZ & FLORACK

PATENTANWALTSBÜRO

SCHUMANNSTR. 97 D-4000 DÜBBELDORF I Teles 0854 6513 cop 4 tauton (02 II) 68 J3 46

PATENTANWALTE

Causing W COHAUSZ

DICK-ING R KNAUF

Diplotting H B COHAUSZ . Diploting D H WERNER

21.4.83

1

Ansprüche

5

10

15

20

25

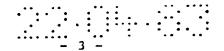
- 1. Dachstein zum einander überlappenden Bedecken geneigter Dachflächen, bei denen in dem von benachbarten Dachsteinen (1) nicht überdeckten Bereich Halbleiterphotoelemente (7) angeordnet sind und unterhalb der Halbleiterphotoelemente (7) der Dachstein (1) einen Hohlraum (4) aufweist, der mit den Hohlräumen (4) der darunter und des darüber liegenden Dachsteins verbungekennzeichnet, dadurch daß die Hohlräume (4) der Dachsteine von unten nach oben von Luft durchströmt sind, die der Umgehungsbzw. Außenluft entnommen wird, daß die Halbleiterphotoelemente (7) in der den Hohlraum abdeckenden Platte (3) angeordnet oder eingelassen sind, und daß diese Platte (3) im wesentlichen lichtundurchlässig ist und ihre Unterseite von der vorbeiströmenden Luft kühlbar ist.
- 2. Dachstein nach Anspruch 1, dadurch kennzeichnet, daß die Unterseite und Seitenwände von einem Grundkörner (2) gebildet sind, der mindestens eine nach oben hin offene Ausnehmung als Hohlraum (4) bildet, der von der Platte (3) oben abgedeckt ist.

30 37 116 HC/Be

- 3. Dachstein nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (2) aus einem Material, insbesondere Beton, gegossen ist.
- 5 4. Dachstein nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Beton ein Polymerbeton ist.
- 5. Dachstein nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da durch gekennzeichnet, daß der
 Hohlraum (4) im oberen überlappenden Bereich mit dem
 Hohlraum des oberen Dachsteins (1) über eine in der
 Oberseite befindliche Öffnung (12) und im unteren überlappenden Bereich über eine in der Unterseite befindliche Öffnung (13) verbunden ist.
 - 6. Dachstein nach einem der Ansprüche 2 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Abdeckplatte (3) an ihrer Unterseite in den Hohlraum (4) hineinragende Kühlrippen (10) trägt, die insbesondere in Richtung der Luftströmung angeordnet sind.
 - 7. Dachstein nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da durch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial der Abdeckplatte (3) ein gießfähiges Material, insbesondere Beton, z.B. ein Polymerbeton, ist.
- 8. Dachstein nach Anspruch 7, d a d u'r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Trägermaterial der
 Abdeckplatte (3) denselben Ausdehnungskoeffizienten
 wie Silizium besitzt.
 - 9. Dachstein nach einem der Ansprüche 2 bis 8, d a -



20



- durch gekennzeichnet, daß die Halbleiterphotoelemente (7) in das Trügermaterial der Abdeckplatte (3) eingegossen sind.
- 5 10. Dachstein nach einem der Ansprücke 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß ober- halb der Halbleiterphotoelemente (7) eine Glasscheibe (9) befestigt ist.
- 10 11. Dachstein nach Anspruch 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zwischen der Glasscheibe (9) und den Halbleiterphotoelementen (7) eine transparente elastische Ausgleichsschicht (8) insbesondere aus Acrylglas angeordnet ist.
- 12. Dachstein nach Anspruch 11, dadurch gekennzeite der Glasscheibe (9) gehärtet ist oder einen harten, kratzfosten Überzug trägt.
 - 13. Dachstein nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberseite der Glasscheibe (9) gegen Reflexionen behandelt ist.
- 25 14. Dachstein nach einem der Ansprüche 2 bis 13, da-durch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial der Abdeckplatte (3) Glas ist.
- 15. Dachstein nach Anspruch 14, d a d u r c h g e
 30 k e n n z e i c h n e t , daß zwischen der Glasschicht
 und den Halbleiterphotoelementen eine elastische Ausgleichsschicht,insbesondere aus Acrylglas, angeordnet
 ist.

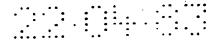
- 16. Dachstein nach einem der Ansprüche 2 bis 15, dagekennzeichnet, daß zwischen dem umlaufenden Rand der Abdeckplatte (3) und dem Grundkörper (2) elastisches Material angeordnet ist.
 - 17. Dachstein nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gékennzeichnet, daß die Anschlußleitungen (15, 16) für die Halbleiterphotoelemente (7) zum Hohlraum (4) durchgeführt sind und in diesem zur Verbindung mit benachbarten Dachsteinen (1) einliegen.
 - 18. Dachstein nach Anspruch 17, dadurch kennzeichnet, daß die Enden der Anschlußleitungen (15, 16) Steckelemente tragen.
 - 19. Dachstein nach einem der Ansprüche 1 bis 18, da durch gekennzeichnet, daß zumindest die Oberseite eben ist.
- 20 20. Dachstein nach einem der Ansprüche 1 bis 19, da durch gekennzeichnet, daß seine äußere Form der eines verkohrsüblichen Dachsteins entspricht.

5

10

15

30



COHAUSZ & FLORACK

PATENTANWALTSHURO

SCHUMANNSTR.97 D-4000 DUSSELDORFT

Telefon (022-10) felt + 1.4%

times into children to

PATRICIANWALTE Committee OMAUSE Carried & KNACE Digitized W. COHAUSZ

Digitals Color Assets 4

21.4.83

5 ~

1

5

BM Chemie Kunststoff GmbH Adolf-Flöring-Str. 22

5678 Wermelskirchen

10

Dachstein

Die Erfindung betrifft einen Dachstein zum einander überlappenden Bedecken geneigter Dachflächen, bei denen in dem von benachbarten Dachsteinen nicht überdeckten Bereich Halbleiterphotoelemente angeordnet sind und unterhalb der Halbleiterphotoelemente der Dachstein einen Hohlraum aufweist, der mit den Hohlräumen der darunter und des darüber liegenden Dachsteins verbunden ist.

20

25

15

Unter Dachsteinen werden Dachpfannen oder Dachziegel verstanden, die die Außenhaut eines geneigten Daches bilden. Es wurde bereits vorgeschlagen, Dachpfa.nen als Sonnenkollektoren auszubilden. Diese bekannten Dachpfannen sind aber aufwendig in Herstellung und Montage auf dem Dach als auch von geringer Leistung. Darüber hinaus liefern sie nur Wärme.

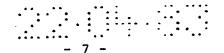
Aus der DE-OS 28 51 975 ist es bekannt, einen Dachziegel

30

37 116 ..C/Be

- der eingangs genannten Art von einem Fluid, wie z.B. Wasser, von oben nach unten im freien Fall durchströmen zu lassen, wobei das durch den Hohlraum fließende Wasser von der Sonnenstrahlung durchstrahlt ist, um es aufzuwärmen. Hierzu ist die ohere Abdeckung durchsichtig. Das Wasser ist im Kreislauf zwangsgeführt, wofür eine Pumpe erforderlich ist. Eine solche Anlage ist verhältnismäßig aufwendig.
- Aus dem DE-GM 79 08 761 ist es bekannt, die Hohlräume von
 Dachsteinen von Luft durchströmen zu lassen, wobei die Luft
 in einem geschlossenen Kreislauf zwangsgeführt ist. Die
 in den Dachziegeln befindlichen Hohlräume nutzen wiederum
 den Treibhauseffekt. Bei beiden bekannten Dachsteinformen
 führt das Durchströmen der in den Dachsteinen befindlichen
 Hohlräume zu Ablagerungen und Verschmutzungen insbesondere
 der Unterseite der lichtdurchlässigen Abdeckplatte, so daß
 schon nach kurzer Zeit der Wirkungsgrad dieser Dachsteine
 erheblich abnimmt.
- Aufgabe der Erfindung ist es, einen Dachstein zu schaffen, der über lange Zeit seinen hohen Wirkungsgrad beibehält und keine aufwendigen Zusatzanlagen erfordert. Auch ist es Aufgabe der Erfindung, einen Dachstein der eingangs genannten Art derart zu verbessern, daß er bei einem optischen Eindruck nahe eines üblichen Dachsteins elektrischen Strom erzeugt und einfach in Herstellung und Montage ist. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, einen Dachstein zu schaffen, der sowohl elektrischen Strom als auch Wärme abführt.
- Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Hohlräume der Dachsteine von unten nach oben von Luft durchströmt sind, die der Umgebungs- bzw. Außenluft entnommen wird, daß die Halbleiterphotoelemente in der den





Hohlraum abdeckenden Platte andeordnet oder eingelassen sind, und daß diese Platte im wesentlichen lichtundurchlässig ist und ihre Unterseite von der vorbeiströmenden Luft kühlbar ist.

5

Bei diesem Dachstein bilden die miteinander verbundenen Hohlräume einer übereinander liegenden Reihe von Dachsteinen einen Luftkanal, der von den Dachsteinen erwärmt wird und damit warme Luft erzeugt.

10

15

Die Hohlräume werden dagegen nicht direkt von den Sonnenstrahlen erreicht, so daß der Treibhauseffekt nicht genutzt wird. Vielmehr besteht eine strenge Trennung zwischen der Nutzung der Sonnenstrahlen durch die Halbleiterphotoelemente und der Nutzung der zusätzlichen Wärme durch Abführung dieser durch den aufsteigenden Luftstrom. Es wird hier der Kamineffekt genutzt. Die Dachsteine behalten stets denselben hohen Wirkungsgrad und erfordern keinen geschlossenen Strömungskreislauf für die Luft.

20

25

30

Die warme Luft kann entweder direkt zum Wärmen verwendet werden oder aber durch Wärmepumpen erhöht und insbesondere gespeichert werden. Die auf der Oberseite der Dachsteine angeordneten Halbleiterphotoelemente erzeugen darüber hinaus Strom, so daß durch diese Dachsteine sowohl ein Absorberdach als auch ein Solarzellendach geschaffen wird. Die in Dachsteinen vorgesehenen Hohlräume bieten darüber hinaus den Vorteil, daß die durch sie hindurchströmende Luft die Halbleiterphotoelemente kühlt, wodurch die Leistung der Halbleiterphotoelemente bzw. der Solarzellen wesentlich erhöht wird.

Eine besonders einfache und insbesondere gießtechnisch vor-



teilhafte Herstellung der Dachsteine wird dadurch erreicht, daß die Unterseite und Seitenwände von einem Grundkörper gebildet sind, der mindestens eine nach oben hin offene Ausnehmung als Hohlraum bildet, die von einer Platte oben abgedeckt ist, die die Halbleiterphotoelemente trägt.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Grundkörper aus einem Material, insbesondere Beton, gegossen ist. Dieses Material ist besonders preiswert und eignet sich für Massenherstellung. Ferner erreicht hierdurch der Dachstein ein ausreichendes Gewicht. Dabei kann der Beton ein Polymerbeton sein.

Um zu erreichen, daß nur aufgrund des Verlegens der Dachsteine in üblicher Weise auf den Dachlatten die Hohlräume der Dachsteine miteinander verbunden werden ehne jeglichen Mehraufwand an Montage; wird vorgeschlagen, daß der Hohlraum im oberen überlappenden Bereich mit dem Hohlraum des oberen Dachsteins über eine in der Oberseite befindliche Öffnung und im unteren überlappenden Bereich über eine in der Unterseite befindliche Öffnung verbunden ist.

Die Abdeckplatten der Dachsteine künnen an ihrer Unterseite in den Hohlraum hineinragende Kühlrippen tragen, wodurch eine gute Kühlung der Halbleiterphotoelemente erreicht wird.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Trägermaterial der Abdeckplatte ein gießfähiges Material, insbesondere Beton, z.B. ein Polymerbeton,ist. Hierdurch kann das Trägermaterial der Abdeckplatte denselben Ausdehnungskoeffizienten wie die Halbleiterphotoelemente besitzen, so daß die Halbleiterphotoelemente micht angegriffen werden. Insbesondere

35

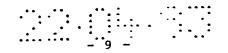
10

15

20

25

30



1 kann der Polymerbeton einen Ausdehrungskoeffisienten von d. = 2,33 besitzen. Aus diesem Grund- können auch die Halbleiterphotoelemente in das Trägermanerial der Abdeckplatte eingegossen werden.

Zum Schutz der Halbleiterphotoelemente wird vorgeschlasin, daß oberhalb dieser eine Classcheibe befestigt ist. Dabei kann zwischen der Glasscheibe und den Halbleiterphotoelementen eine transparente, elastische Ausgleichsschicht insbesondere aus Acrylglas angeordnet sein, um unterschiedliche Ausdehnungen zuzulassen. Vorzugsweise ist die Oberseite der Glasscheibe gehärtet oder trägt einen harton, kratzfesten Überzug, um auch über längere Zeit einen optimalen Strahlendurchgang zuzulassen. Hierzu wird auch vorgeschlagen, daß die Oberseite der Glasscheibe gegen Berflexionen behandelt ist.

Alternativ wird vorgeschlagen, daß das Trägermaterial der Abdeckplatte Glas ist. In diesem Fall wird vorgeschlagen, daß zwischen der Glasschicht und den Halbleiterphotoelementen eine elastische Ausgleichsschicht, insbesondere aus Acrylglas, angeordnet ist.

Vorzugsweise wird vorgeschlagen, daß zwischen dem umlaufenden Rand der Abdeckplatte und dem Grundkörper elastisches Material angeordnet ist. Dieses elastische Material hat die Aufgabe, die Abdeckplatte abzudichten, mit dem Grundkörper zu verbinden und einen Ausdehnungsausgleich zu schaffen.

Ferner wird vorgeschlagen, daß die Anschlußleitungen für die Halbleiterphotoelemente zum Hohlraum durchgeführt sind und in diesem zur Verbindung mit benachbarten Dach-



30

5

10

15

20

steinen einliegen. Die Hohlräume werden hiermit besonders vorteilhaft für die Führung der elektrischen Leitungen genutzt. Die elektrischen Leitungen liegen hier trocken und geschützt ein. Dabei können die Enden der Anschlußleitungen Steckelemente tragen, wodurch schon während des Auflegens der Dachsteine die Leitungen ohne großen Montageaufward aneinander angeschlossen werden können.

Ein besonders hoher Wirkungsgrad wird dann erreicht, wenn die Oberseite der Dachsteine eben ist. Das Dach unterscheidet sich von üblichen Dächern dann nicht, wenn die äußere Form der Dachsteine verkehrsüblichen Dachsteinen entspricht.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Dachstein;
- 20 Fig. 2 einen Schnitt nach A-A in Fig. 1;
 - Fig. 3 einen Schnitt nach B-B in Fig. 1; und
 - Fig. 4 einen Ausschnitt X in Fig. 2.

Der Dachstein 1 weist die Form eines hohlen Kastens auf, dessen äußere Abmessungen denen eines üblichen Dachsteins bzw. Dachpfanne oder Dachziegels entspricht. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Länge größer als die Breite und die Höhe bzw. die Stärke nur einen Bruchteil der Breite. Der Dachstein besteht aus zwei Teilen, und zwar dem Grundkörper 2 und einer darauf liegenden Deckplatte 3. Der Grundkörper 2 ist entsprechend einem nach oben hin

35

30

25

10





offenen Kasten ausgebildet, so daß er einen flachen, nach 1 oben hin offenen Hohlraum 4 besitzt, der noch durch eine senkrechte Mittelwand 5 geteilt ist und an zwei senkrechten Außenwänden vorspringende, angeformte Leisten 6 aufweist, die Falze tragen, in die Falze benachbarter Dach-5 steine überlappend einliegen.

Der Hohlraum 4 ist oben durch eine Abdeckplatte 3 abgeschlossen, die, wie auch der Grundkörper 2, aus Beton, insbesondere einem Polymerbeton, besteht. Dabei trägt die Abdeckplatte 3 Halbleiterphotoelemente 7, die oben aufliegen oder aber in den Beton eingegossen sind. Hierzu weist der Polymerbeton den gleichen Ausdehnungskoeffizienten von & = 2,33 wie das Silizium der Halbleiterphotoelemente 7 auf. Oberhalb der Halbleiterphotoelemente liegt eine elastische Acrylausgleichsschicht 8 und darüber eine Glasscheibe 9, deren Oberfläche gehärtet ist und gegen Reflexe behandelt wurde.

Ein optisch einheitlicher und den üblichen Dachsteinen entsprechender Eindruck wird dadurch erzielt, wenn der Polymerbeton und die Solarzellen schwarz gefärbt sind.

An der Unterseite der Abdeckplatte 3 ragen in den Hohlraum 4 Kühlrippen 10 hinein. die in Richtung der durchströmenden Luft liegen. In den Bereichen, in denen die Dachsteine einander oben und unten überlappen, weisen die Abdeckplatte 3 und der Grundkörper 2 miteinander übereinstimmende bzw. fluchtende Öffnungen 12 und 13 auf, so daß die Luft von dem untersten Dachstein zu dem darüber liegenden usw. nach oben durch alle Dachsteine strömen kann. Eine an der Unterseite des Grundkörpers 2 angeord-

10

15

20

25

nete Nase 14 erlaubt einen Halt des Dachsteins an den Dachlatten.

An der Unterseite aus der Abdeckplatte 3 herausragende Leitungen sind durch den Hohlraum 4 und die Öffnungen 12, 13 geführt und erlauben über Stecker und Buchsen einen elektrischen Anschluß mit den Halbleiterphotoelementen benachbarter Dachsteine.

Die Abdeckplatte 3 kann in einer alternativen Ausführung statt aus Beton auch aus Glas hergestellt sein, wobei dann zwischen dieser Glasschicht und den Halbleiterphoto-elementen eine weitere elastische Acrylausgleichsschicht angeordnet ist.

Die die Hohlräume der Dachsteine durchströmende Luft wird der kühlen Umweltluft entnommen. Nachdem die Luft durch den Kamineffekt oben angelangt ist, wird sie entweder direkt zum Wärmen von Gebäuden benutzt oder einem Wärmetauscher zugeführt. Ein Rückführen der Luft zum untersten Dachstein ist nicht beabsichtigt, da dies aufwendig ist.

25

1

5

10

15

20

30

35

- 13-Leerseite

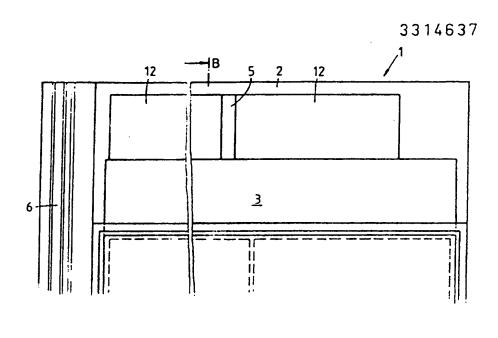
Nummer: Int. Cl.³:

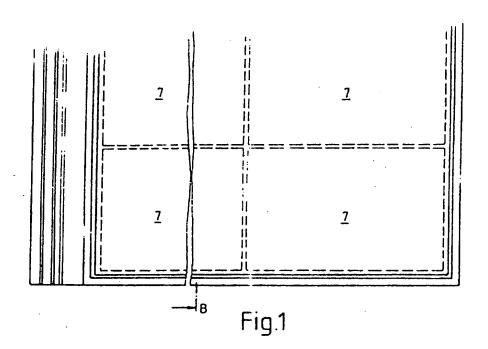
33 14 637 E 04 D 1/28 22. April 1983

Anmeldetag: Offenlegungstag:

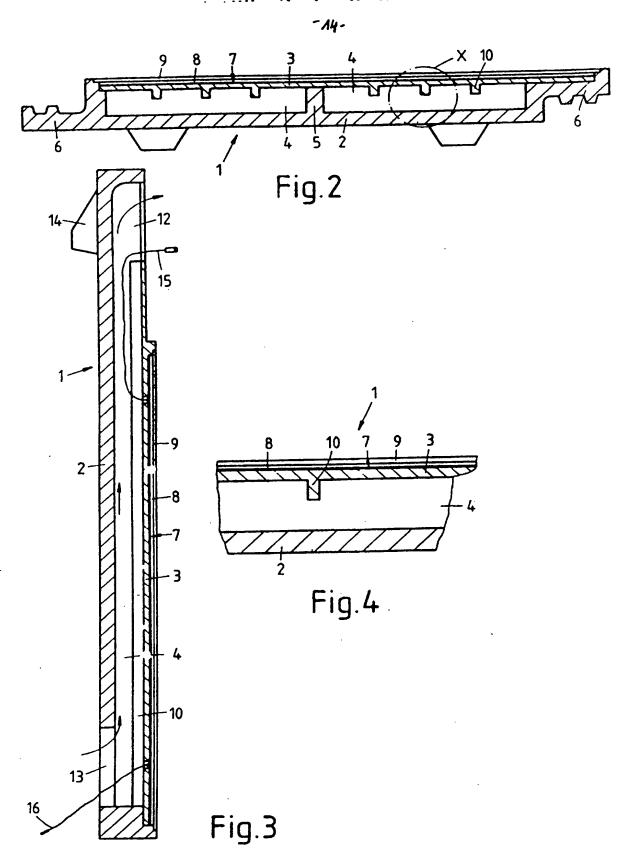
17. November 1983

- 15-









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.